



Programm

Fachsymposium Crossing Frontiers in Microelectronics

28. September 2023, Berlin

Fachsymposium

CROSSING FRONTIERS IN MICROELECTRONICS

10:00 – 16:00 Uhr



10:00

Begrüßung

Rolf Aschenbrenner und Dr. Tanja Braun | Fraunhofer IZM

Semiconductor Foundries View on Heterogenous Integration
Dr. Isabelle Ferain | GlobalFoundries

Advanced Packaging für den Anwendungsbereich High Performance Computing
Dr. Michael Schiffer | Fraunhofer IZM

Kaffeepause

Sensorsysteme für Leading Edge Consumer Anwendungen
Dr. Stefan Ruebenacke | Bosch Sensortec GmbH

Integrationslösungen für modulare Kommunikationselektronik der 5. und 6. Generation
Dr. Michael Kaiser und Dr. Julia-Marie Köszegi | Fraunhofer IZM

13:00

Mittagspause

14:00

Hochintegrierte energieeffiziente mikroelektronische Systeme für zukünftige optische und mobile Anwendungen
Prof. Friedel Gerfers | Technische Universität Berlin

Technologietrends in der Leistungselektronik
Prof. Eckart Hoene | Fraunhofer IZM

Von der Machbarkeit zum marktfähigen Advanced Package
Robert Giertz | AEMtec GmbH

Bringt uns die Mikrointegration auf den 1,5-Grad-Pfad?
Karsten Schischke | Fraunhofer IZM

16:00

Kaffeepause

FESTAKT

17:00–19:00 Uhr



Begrüßung

Prof. Martin Schneider-Ramelow
Fraunhofer IZM

Grußworte

Prof. Axel Müller-Groeling
Vorstand »Forschungsinfrastrukturen und Digitalisierung«,
Fraunhofer-Gesellschaft

Dr. Henry Marx

Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Berlin

Dr. Roland Krüppel

Referat »Elektronik und autonomes Fahren; Supercomputing«
im Bundesministerium für Bildung und Forschung

Prof. Geraldine Rauch

Präsidentin Technische Universität Berlin

Dr. Axel Kaschner

Senior Vice President »Corporate Research, Advanced Technologies«,
Robert Bosch GmbH

Danksagungen, Ehrung, Highlights

Prof. Martin Schneider-Ramelow
Fraunhofer IZM

Ab 19.00 Uhr: **Get-together**



Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM

Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin
www.izm.fraunhofer.de

